

Кластер ПХТ А1

Промышленно-ориентированный кластерный комплекс
плазмохимического травления (ICP RIE) для пластин диаметром 200 мм



Технические характеристики

Характеристика	Модуль удаления фоторезиста (2 шт.)*		Модуль травления	
Скорость травления/ удаления фоторезиста нм/мин	>1000		>250	
Максимальная мощность генераторов, Вт	ВЧ/СВЧ - источник : 3000		Стола - 1000 Индуктора - 2000	
Рабочее давление, Па	100÷400		1÷10	
Диапазон температур нагрева пластин, °С	5÷60	5÷60	5÷60	100÷300

*Конфигурация технологических модулей может быть изменена по
желанию заказчика

- Система загрузки SMIF - контейнер
- Обработка пластин Ø 200 мм
- Механический/электростатический прижим пластин
- Масса не более 3500 кг, включая транспортную систему
- Габариты (ШхГхВ) не более 5000х4500х2200 мм

